

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年3月22日
【会社名】	シャープ株式会社
【英訳名】	Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 奥田 隆 司
【本店の所在の場所】	大阪市阿倍野区长池町22番22号
【電話番号】	(06)6621 1221(代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部証券財務部長 浅田 秀 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号 シャープ株式会社東京支社
【電話番号】	(03)5446 8221(代表)
【事務連絡者氏名】	経理本部IR室副参事 佐藤 裕 史
【届出の対象とした募集有価証券の種類】	株式
【届出の対象とした募集金額】	その他の者に対する割当 5,753,910,000円 ただし、上記は、後記「第一部〔証券情報〕第1 〔募集要項〕2〔株式募集の方法及び条件〕 (1)〔募集の方法〕(注)4」に記載の発行価 額の総額の暫定値であり、有価証券届出書提出時 における見込額であります。
【安定操作に関する事項】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	シャープ株式会社東京支社 (東京都港区芝浦一丁目2番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類	発行数	内容
普通株式	18,561,000株（注）3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 1,000株

（注） 1 平成25年3月22日（金）開催の当社取締役会（以下「本取締役会」といいます。）の決議によります。なお、本取締役会の決議では、本有価証券届出書に係る第三者割当による新株発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）に係る諸条件を決定しておりますが、発行数及び払込期日が確定していないため、本第三者割当増資に関しては、会社法第199条第1項に規定する募集株式の発行に係る決定のための取締役会決議を経ておりません。発行数及び払込期日が確定次第、本第三者割当増資につき会社法第199条第1項で求められる取締役会決議を行う予定です。

2 振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

3 発行数は、発行価額の総額として予定している60百万USドルを発行価格確定の時点の為替レートにより日本円に換算した額（1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。）（以下「発行価額予定額」といいます。）を、後記「2【株式募集の方法及び条件】（2）【募集の条件】」記載の発行価格で除した数（1,000株未満の数が生じたときはこれを切り捨てます。）となる予定です。なお、かかる算式により算出された本第三者割当増資による発行数が、第1次第三者割当増資（後記「2【株式募集の方法及び条件】（2）【募集の条件】（注）7」で定義しております。）によって発行された株式数とあわせて当社の発行済株式総数の10%以上となる場合には、割当予定先と協議を行うことになっております。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資（後記「2【株式募集の方法及び条件】（2）【募集の条件】（注）7」で定義しております。）と同じです。

上記の発行数は、発行価額の総額として予定している60百万USドルを本有価証券届出書提出日の直近の日である平成25年3月21日における為替レート（95.90円/USドル）を用いて日本円に換算し、後記「2【株式募集の方法及び条件】（2）【募集の条件】」記載の発行価格の暫定数値である310円で除して算出した暫定数値です。

4 本第三者割当増資については、発行数及び払込期日の確定後、本有価証券届出書に係る訂正届出書（以下「本訂正届出書」といいます。）を提出し、その効力が生じない限り実施されません。

2【株式募集の方法及び条件】

（1）【募集の方法】

区分	発行数	発行価額の総額（円）	資本組入額の総額（円）
株主割当	-	-	-
その他の者に対する割当	18,561,000株（注）3	5,753,910,000（注）4	2,876,955,000（注）5
一般募集	-	-	-
計（総発行株式）	18,561,000株（注）3	5,753,910,000（注）4	2,876,955,000（注）5

（注） 1 第三者割当の方法によります。

2 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額であります。また、増加する資本準備金の額は、発行価額の総額から資本組入額の総額を控除した残額になります。

- 3 発行数は、発行価額予定額を、後記「2〔株式募集の方法及び条件〕(2)〔募集の条件〕」記載の発行価格で除した数(1,000株未満の数が生じたときはこれを切り捨てます。)となる予定です。上記の発行数は、前記「1〔新規発行株式〕」記載の発行数の暫定数値です。
- 4 発行数に後記「2〔株式募集の方法及び条件〕(2)〔募集の条件〕」記載の発行価格を乗じた額となります。上記の発行価額の総額は、上記発行数の暫定数値に対して、後記「2〔株式募集の方法及び条件〕(2)〔募集の条件〕」記載の発行価格の暫定数値である310円を乗じて算出した暫定数値です。
- 5 発行価額の総額を2で除した額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。)となります。上記の資本組入額の総額は、上記発行価額の総額の暫定値を前提に算出した暫定数値です。

(2) 【募集の条件】

発行価格 (円)	資本組入額 (円)	申込株数 単位	申込期間	申込証拠金 (円)	払込期日
310 (注) 5	155 (注) 6	1,000株	平成25年6月28日(注) 8	-	平成25年6月28日(注) 8

- (注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
- 2 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。
- 3 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、上記申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、上記払込期日の期間内に後記払込取扱場所へ発行価格（会社法上の払込金額）の総額を払込むものとし、
- 4 申込期間内に、割当予定先から申込みがない場合は、本第三者割当増資は行われなないこととなります。
- 5 発行価格は、本取締役会において次のとおり決定しております。
- 本追加投資主要条件（以下で定義します。）が充足した日（以下「追加投資主要条件充足日」といいます。）の2営業日前の日から遡った20営業日間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。）に相当する価格とします。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資（後記「2〔株式募集の方法及び条件〕（2）〔募集の条件〕（注）7」で定義しております。）と同じです。
- 上記の発行価格は、追加投資主要条件充足日を平成25年3月21日と想定した上で、上段に定める発行価格の算式を前提に、そこから2営業日前の日である平成25年3月18日から遡った20営業日間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値（1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。）に相当する310円として算出した暫定数値です。発行価格は追加投資主要条件充足日がいつになるかによって変動いたします。
- 6 資本組入額は、前記「（1）〔募集の方法〕」に記載の資本組入額の総額を、前記「1〔新規発行株式〕」に記載の発行数で除した金額とします。上記の資本組入額は、前記「（1）〔募集の方法〕」に記載の資本組入額の総額の暫定数値を、前記「1〔新規発行株式〕」に記載の発行数の暫定数値で除して算出した暫定数値です。
- 7 本第三者割当増資に関する決定を本取締役会で行った経緯は下記のとおりです。
- 平成24年12月4日開催の当社取締役会（以下「当初取締役会」といいます。）において、第三者割当による当社普通株式30,120,000株の発行（以下「第1次第三者割当増資」といいます。詳細につきましては、平成24年12月4日提出の当該新株式発行に係る有価証券届出書をご参照ください。）及び申込期間を平成25年3月28日、払込期日を平成25年3月29日とした当社普通株式の発行（以下「旧第2次第三者割当増資」といいます。）を同時に決議しました。第1次第三者割当増資及び旧第2次第三者割当増資はともに、Qualcomm Incorporated（以下「Qualcomm」といいます。）を割当予定先とする第三者割当増資でしたが、これは、当社がQualcommの100%出資子会社であるPixtronix, Inc.（以下「Pixtronix」といいます。）との間で平成24年12月4日に締結した、次世代型と位置づけるMEMS（Micro Electro Mechanical System：微小電子機械システム）ディスプレイ（以下「次世代MEMSディスプレイ」といいます。）の共同開発を目的とする業務提携に関する共同開発契約（以下「共同開発契約」といいます。）及びQualcommとの間の第三者割当増資に関する出資引受契約（以下「出資契約」といいます。共同開発契約とあわせて「共同開発・出資契約」といいます。）の一環として実施を予定していたものです。

共同開発・出資契約では、次世代MEMSディスプレイが新技術を使用したものであるところ、その研究開発及び実用化技術の確立にあたっては、二段階に分けて実施することとしています。具体的には、共同開発・出資契約では、まず、第一段階として、両社の技術を持ち寄った上で、当該次世代MEMSディスプレイの開発に関する研究開発及び設備投資を開始し、次世代MEMSディスプレイに関する実用化技術確立の目処を確認することとし、第一段階における研究開発及び設備投資が下記本追加投資主要条件として定める条件を充足した場合、第二段階としての次世代MEMSディスプレイの更なる開発及び実用化に向けての研究開発に追加資金が必要になることから、追加の第三者割当増資をQualcommに対して行い当該資金需要に対応することとしています。当該第二段階に進むための追加資金を調達する目的の第三者割当増資につきましては、共同開発・出資契約で定めた、当該第三者割当増資実施のための条件(すなわち、ディスプレイモジュールの製品仕様の確立、設備の導入に関する計画作成及びその他研究開発に必要な資源・体制の確保等の諸条件が完了していることを両社で確認すること、並びに当社が連結ベースで平成24年度下半期営業黒字化を実現すること、平成25年3月31日付で純資産1,000億円及び現預金1,250億円を有すること(あるいは平成25年3月31日前に払込みが行われる場合には数値が達成される見込みがあること)が満たされていること(以下、「本追加投資主要条件」といいます。))が充足した時点で、本訂正届出書を提出し、申込期間までに、同届出書の効力が生じること(以下「本追加投資条件」といいます。)を条件に第三者割当増資を実施し、実用化技術開発の第二段階に移行することとしております。

かかる共同開発の第二段階に進むための追加資金を調達する目的で、当初取締役会では、旧第2次第三者割当増資を決議し、旧第2次第三者割当増資に係る有価証券届出書を平成24年12月4日に提出しておりました。その後、両社による共同研究を進めてきた結果、両社間で条件充足の確認に向けて協議を継続中であり、本追加投資主要条件の充足の確認に関して、精度及び確実性の高い情報及び状況を前提に慎重に判断するために暫くの時間の猶予が必要であるとの両社認識に至ったことを踏まえて、平成25年3月29日を払込期日とした旧第2次第三者割当増資を一旦取り止めることとし、当該有価証券届出書を平成25年3月22日に取り下げております。

共同開発・出資契約においては、平成25年3月29日までに本追加投資条件の充足が困難な場合には、第二段階の共同開発に移ることにつき3か月の猶予を設け、平成25年6月30日まで延長するとしていたことから、かかる規定に基づき、両社で協議した結果、共同開発・出資契約における共同開発の第二段階の追加資金に充てる手段として、旧第2次第三者割当増資に代わるものとして、本第三者割当増資を行うことを決定するに至ったものです。本第三者割当増資に関しては、上記のとおり、共同開発・出資契約の規定に基づき、本追加投資主要条件が充足したことを確認し、かつ、当該確認を受けて本訂正届出書を提出し、上記申込期間までに同届出書の効力が生じること条件として実施いたします。一方、仮に、本追加投資主要条件が充足しない場合には、第二段階にかかる資金は不要になることから、本第三者割当増資は実行されないこととなります。

- 8 申込期間及び払込期日については、上記のとおり予定しておりますが、本追加投資主要条件が充足し、前記「2〔株式募集の方法及び条件〕(2)〔募集の条件〕(注)5」及び「2〔株式募集の方法及び条件〕(1)〔募集の方法〕(注)3」記載の方法に従い当社取締役会で発行価格及び発行数を決定した日(以下「本第三者割当増資条件確定日」といいます。)に正式に決定する予定であります。この点、上記のとおり、本追加投資主要条件の充足に関しては両者で協議中であるものの、本追加投資主要条件の充足につき両社で合理的に満足する形で確認できる時点に関しては、現時点では一義的に決められないため、両社での協議を踏まえて、共同開発・出資契約において第二段階の共同開発に移ることの猶予期間である平成25年6月30日までにおける最終日(ただし払込受領との関係で金融機関休業日である平成25年6月29日及び30日を除きます。)である平成25年6月28日を払込期日の予定日としています。なお、当該日前であっても本追加投資主要条件の充足が確認出来次第、共同開発・出資契約に基づき、可及的速やかに本訂正届出書を提出し、本訂正届出書の効力が発生次第速やかに本第三者割当増資を実施いたします。本追加投資主要条件の充足に関して精度及び確実性の高い情報及び状況に基づき両社が合理的に満足する形で確認することができることになると見込まれる日以降の各日において本第三者割当増資条件確定日となった場合の申込期間及び払込期日は下記のとおりとなります。

本第三者割当増資条件確定日	申込期間	払込期日
平成25年3月23日乃至同年3月25日	平成25年4月10日	平成25年4月10日
平成25年3月26日	平成25年4月11日	平成25年4月11日
平成25年3月27日	平成25年4月12日	平成25年4月12日
平成25年3月28日及び同年3月29日	平成25年4月15日	平成25年4月15日
平成25年3月30日乃至同年4月1日	平成25年4月17日	平成25年4月17日
平成25年4月2日	平成25年4月18日	平成25年4月18日
平成25年4月3日	平成25年4月19日	平成25年4月19日
平成25年4月4日及び同年4月5日	平成25年4月22日	平成25年4月22日
平成25年4月6日乃至同年4月8日	平成25年4月24日	平成25年4月24日
平成25年4月9日	平成25年4月25日	平成25年4月25日
平成25年4月10日	平成25年4月26日	平成25年4月26日
平成25年4月11日及び同年4月12日	平成25年4月30日	平成25年4月30日
平成25年4月13日乃至同年4月15日	平成25年5月1日	平成25年5月1日
平成25年4月16日	平成25年5月2日	平成25年5月2日
平成25年4月17日乃至同年4月19日	平成25年5月7日	平成25年5月7日
平成25年4月20日乃至同年4月22日	平成25年5月8日	平成25年5月8日
平成25年4月23日	平成25年5月9日	平成25年5月9日
平成25年4月24日	平成25年5月10日	平成25年5月10日
平成25年4月25日及び同年4月26日	平成25年5月13日	平成25年5月13日
平成25年4月27日乃至同年4月30日	平成25年5月16日	平成25年5月16日
平成25年5月1日	平成25年5月17日	平成25年5月17日
平成25年5月2日	平成25年5月20日	平成25年5月20日
平成25年5月3日乃至同年5月7日	平成25年5月23日	平成25年5月23日
平成25年5月8日	平成25年5月24日	平成25年5月24日
平成25年5月9日及び同年5月10日	平成25年5月27日	平成25年5月27日
平成25年5月11日乃至同年5月13日	平成25年5月29日	平成25年5月29日
平成25年5月14日	平成25年5月30日	平成25年5月30日
平成25年5月15日	平成25年5月31日	平成25年5月31日
平成25年5月16日及び同年5月17日	平成25年6月3日	平成25年6月3日
平成25年5月18日乃至同年5月20日	平成25年6月5日	平成25年6月5日
平成25年5月21日	平成25年6月6日	平成25年6月6日
平成25年5月22日	平成25年6月7日	平成25年6月7日
平成25年5月23日及び同年5月24日	平成25年6月10日	平成25年6月10日
平成25年5月25日乃至同年5月27日	平成25年6月12日	平成25年6月12日

本第三者割当増資条件確定日	申込期間	払込期日
平成25年 5月28日	平成25年 6月13日	平成25年 6月13日
平成25年 5月29日	平成25年 6月14日	平成25年 6月14日
平成25年 5月30日及び同年 5月31日	平成25年 6月17日	平成25年 6月17日
平成25年 6月 1日乃至同年 6月 3日	平成25年 6月19日	平成25年 6月19日
平成25年 6月 4日	平成25年 6月20日	平成25年 6月20日
平成25年 6月 5日	平成25年 6月21日	平成25年 6月21日
平成25年 6月 6日及び同年 6月 7日	平成25年 6月24日	平成25年 6月24日
平成25年 6月 8日乃至同年 6月10日	平成25年 6月26日	平成25年 6月26日
平成25年 6月11日	平成25年 6月27日	平成25年 6月27日
平成25年 6月12日	平成25年 6月28日	平成25年 6月28日

本第三者割当増資は、上記各払込期日において本追加投資条件の充足が維持されていることを条件に実行されます。

- 9 本第三者割当増資により発行される株式に関し、平成25年 6月開催予定の当社定時株主総会に係る議決権の付与はいたしません。
- 10 上記のとおり、本第三者割当増資と第1次第三者割当増資は、ともに共同開発・出資契約に基づく次世代MEMSディスプレイの共同開発・実用化技術の確立のための投資のために行われるものです。次世代MEMSディスプレイの共同開発について、このように二段階に分けた第三者割当増資を行うことにより、Qualcommとしては次世代MEMSディスプレイの開発に投資を行うリスクを軽減できるメリットがあると考えております。特に、次世代MEMSディスプレイの実用化技術の確立のための開発については多額の追加投資が必要になるところ、当社といたしましては、Qualcommから次世代MEMSディスプレイの実用化技術確立の目処が立った段階における追加資金調達に関する事実上の確約をあらかじめ取得しておくことが望ましいと考え、Qualcommとの二段階に分けた第三者割当増資を前提にした共同開発・出資契約を平成24年12月4日に締結したものです。
- 11 共同開発・出資契約の具体的な内容は以下のとおりです。

(1) 次世代MEMSディスプレイの実用化技術の開発

Pixtronixが保有するMEMSディスプレイに関する技術と当社が保有するIGZO-TFT技術とを統合することにより、更なる高画質と低消費電力といった特長を実現するモバイル機器向け次世代MEMSディスプレイの共同開発を行います。当該次世代MEMSディスプレイの開発にあたっては、当社子会社のシャープ米子株式会社（鳥取県米子市、以下「シャープ米子」といいます。）にある液晶パネル工場に実用化技術の研究開発を行うための設備を導入します。

当社はシャープ米子に導入した設備に必要な人的・物的経営資源を、上記共同開発の実施中、継続的に投資します。

かかる次世代MEMSディスプレイの共同開発及び実用化技術の研究開発は、二段階で行うものとします。第一段階として、当社は当該次世代MEMSディスプレイの開発に関する研究開発及び設備投資を開始します。第一段階における実用化技術の開発において本追加投資条件を充足した時点で、実用化技術開発の第二段階に移行します。具体的には、設備の試験稼動といった製品化に向けた研究開発により実用化技術を確立します。

(2) 実用化技術開発完了後の販売体制等

次世代MEMSディスプレイに係る上記技術開発及び実用化技術開発の完了後、製造・販売体制に関しては両社で協議の上決定します。

(3) 第三者割当増資の実施

Qualcommに対し、平成24年12月27日を払込期日とする第1次第三者割当増資（同払込期日において30,120,000株を発行し払込みが完了しています。第1次第三者割当増資後の発行済株式総数に対する割合2.64%、議決権総数に対する割合2.68%となっています。）、また上記を払込期日とする本第三者割当増資（ただし、かかる申込期間までに本追加投資条件が充足することを条件とします。）の2回に分けて新株式の発行を行います。第1次第三者割当増資により前述の第一段階の研究開発を、本第三者割当増資により第二段階の研究開発を行います。

出資契約上、Qualcommには当社に対する取締役を指名・派遣する権利その他当社の経営等に関する特別な権利等は付与されておらず、また、本有価証券届出書提出日現在において、出資契約に伴うQualcommからの取締役の受け入れの予定はありません。

(4) その他条件

第1次第三者割当増資が実施された後、本追加投資条件が充足しないことを理由として本第三者割当増資が実施されない場合でも、当社は2年間は共同研究を継続するように努めます。

(3)【申込取扱場所】

店名	所在地
シャープ株式会社	大阪市阿倍野区長池町22番22号

(4)【払込取扱場所】

店名	所在地
株式会社三菱東京UFJ銀行 大阪営業部	大阪府中央区伏見町三丁目5番6号

3【株式の引受け】

該当事項はありません。

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

本第三者割当増資に係る手取金の額は下記のとおりとなっております。

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
5,753,910,000(注)3	94,000,000	5,659,910,000(注)4

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
 2 発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用(約20百万円)、弁護士及び財務アドバイザー費用(約45百万円)、取引所上場関係費用(約9百万円)及びその他(約20百万円)です。
 3 前記「2〔株式募集の方法及び条件〕(1)〔募集の方法〕」に記載の発行価額の総額になります。なお、当該発行価額の総額は、発行価額予定額を前提にして、前記「2〔株式募集の方法及び条件〕(1)〔募集の方法〕」に記載の計算方法で確定されるところ、発行価額予定額に近い額となると見込まれております。上記の払込金額の総額は、前記「2〔株式募集の方法及び条件〕(1)〔募集の方法〕」に記載の発行価額の総額の暫定数値を前提にした暫定数値になります。
 4 払込金額の総額から発行諸費用の概算額を控除した額になります。上記の差引手取概算額は、上記払込金額の総額の暫定数値を前提にした暫定数値になります。

なお、第1次第三者割当増資に係る手取金の額は以下のとおりとなっております。

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
4,939,680,000	228,000,000	4,711,680,000

- (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
 2 発行諸費用の概算額の内訳は、登記費用(約35百万円)、弁護士及び財務アドバイザー費用(約165百万円)、取引所上場関係費用(約8百万円)及びその他(約20百万円)です。

(2)【手取金の使途】

上記手取金の具体的な使途については、次のとおり予定しております。また、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

具体的な使途	金額	支出予定時期
次世代MEMSディスプレイ生産技術開発経費（注）1	1,200百万円	平成25年6月～平成26年12月
次世代MEMSディスプレイ生産技術開発用設備投資（注）1	4,460百万円	平成25年6月～平成26年12月

- （注） 1 当社は、次世代MEMSディスプレイの実用化の技術を確立次第、次世代MEMSディスプレイの実際の実用化に必要な生産ラインその他必要な生産設備を設置することを予定しており、本第三者割当増資の手取金はそのために必要な設備投資に充当する予定です。
- 2 前記「2〔株式募集の方法及び条件〕（2）〔募集の条件〕」に記載のとおり、本第三者割当増資は、本追加投資条件を充足せず、次世代MEMSディスプレイの研究開発の成功の見込みが明らかに認められないような場合には、上記「具体的な使途」に記載の資金は不要になることから、本第三者割当増資は実行されず、この場合、上記の次世代MEMSディスプレイの開発及び実用化に必要な技術を確立するための研究開発も実施されません。
- 3 本第三者割当増資に関しては、発行数及び払込期日の確定後、本訂正届出書を提出し、その効力が生じない限り実施されませんので、上記はあくまで本有価証券届出書提出時点での見込みとなります。また、上記の各具体的な使途にかかる各金額は、前記「2〔株式募集の方法及び条件〕（1）〔募集の方法〕」に記載の発行価額の総額の暫定数値を前提に発行諸費用の概算額を控除して算出した本第三者割当増資の手取金の暫定数値を前提としておりますが、当該各資金使途に関してはかかる暫定数値による額で当然に全額が賄われるものではなく、最終的に本追加投資主要条件の充足が確認され発行価額の総額が確定した場合にはその全額を上記各資金使途に充当する予定です。

当社が平成24年3月27日に提出した有価証券届出書に係る鴻海精密工業股? 有限公司等を割当予定先とする第三者割当増資（以下「平成24年3月27日決議第三者割当増資」といいます。）では、モバイル機器関連の液晶製造設備の増強・合理化及び液晶ディスプレイの新規技術導入に係わる投資等を資金使途として想定していましたが、本第三者割当増資及び第1次第三者割当増資による資金は、上記及び下記のとおり今回の共同開発に係る次世代MEMSディスプレイの共同開発・実用化技術の確立のために充当されるものであり、平成24年3月27日決議第三者割当増資とは異なる資金使途に基づいて行われるものです。また、当社は、平成25年3月6日に提出した有価証券届出書に係るサムスン電子ジャパン株式会社（以下「サムスン電子ジャパン」といいます。）を割当予定先とする第三者割当増資（以下「平成25年3月6日決議第三者割当増資」といいます。）を決議しておりますが、これは、当社が、新たな事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を継続的に推進することを目的とした、モバイル機器関連の液晶製造設備の増強・合理化、及び液晶ディスプレイの新規技術導入に係わる投資等の計画の実行に際して必要な資金を調達するためのものであって、今回の共同開発に係る次世代MEMSディスプレイの共同開発・実用化技術の確立のために充当することを目的とする本第三者割当増資及び第1次第三者割当増資とは異なる資金使途に基づくものです。なお、平成24年3月27日決議第三者割当増資に関しては、払込期日が平成25年3月26日と迫っておりますが、現時点で払込みの実施に関してまだ協議中です。

また、共同開発・出資契約に基づくQualcommからの出資は当社の資本政策にも資するものですが、あくまでその主眼は次世代MEMSディスプレイ技術・実用化技術の確立のための体制構築にあり、平成24年3月27日決議第三者割当増資又は平成25年3月6日決議第三者割当増資に代わる資本政策として位置づけるものではありません。

スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器の市場拡大が進むにつれ、搭載するディスプレイにも更なる視認性の高さや低消費電力化が求められています。MEMSディスプレイの特長である高い色再現性にIGZO-TFT技術の特長である高速応答かつ低消費電力などを生かした次世代の高付加価値ディスプレイを開発することは、当社が今後成長を持続するために不可欠であり、中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与すると見込まれるため、そのための研究開発及び設備投資費用である上記資金用途には合理性があるものと判断しております。

なお、第1次第三者割当増資により調達した資金の具体的な用途、金額及び支出予定時期は下記のとおりとなっております。

具体的な用途	金額	支出予定時期
次世代MEMSディスプレイ開発経費(注)	3,300百万円	平成24年12月～平成25年3月
次世代MEMSディスプレイ開発用設備投資(注)	1,400百万円	平成24年12月～平成25年3月

(注) 当該次世代MEMSディスプレイの開発にあたっては、実用化技術に関する研究開発を行うための設備などを構築することを予定しており、本有価証券届出書提出時点では、基本的に上記に沿う形で支弁しております。

第2【売出要項】

該当事項はありません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

第三者割当による新株式の発行について

前述のとおり、当社は、共同開発・出資契約に基づく第三者割当増資として、当初取締役会において第1次第三者割当増資を決議し、また、本取締役会において本第三者割当増資を決議しております。第1次第三者割当増資の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、平成24年12月4日提出の第1次第三者割当による新株式発行に係る有価証券届出書をご参照ください。

共同開発・出資契約に基づく、本第三者割当増資と第1次第三者割当増資とで、二段階の第三者割当増資とした理由は、以下のとおりであります。

次世代MEMSディスプレイは新技術を使用したものであるところ、その研究開発及び実用化技術の確立にあたっては、共同開発・出資契約に従い、二段階に分けて実施することを想定しております。具体的には、共同開発・出資契約では、まず、第一段階として、両社の技術を持ち寄った上で、次世代MEMSディスプレイの開発に関する研究開発及び設備投資を開始し、実用化技術確立の目処を確認します。次に、第一段階における研究開発及び設備投資が本追加投資条件として定める条件を充足した場合、第二段階としての次世代MEMSディスプレイの更なる開発及び実用化に向けての研究開発には追加資金が必要になることから、本第三者割当増資に基づいてQualcommが当該資金需要に対応することといたしました。本第三者割当増資につきましては、本追加投資条件が充足する場合に限り行われることとなっております。一方、仮に、本追加投資条件を充足しない場合、本第三者割当増資は実行されないこととなります。

このように、共同開発・出資契約による次世代MEMSディスプレイの共同開発・実用化技術の確立につき二段階に分けた資本投下が必要になるところ、本第三者割当増資と第1次第三者割当増資による二段階の第三者割当増資としたものです。

次世代MEMSディスプレイの共同開発について、このような二段階に分けた第三者割当増資を行うことにより、Qualcommとしては次世代MEMSディスプレイの開発に投資を行うリスクを軽減できると考えております。また、当社といたしましては、Qualcommから次世代MEMSディスプレイの実用化技術確立の目処が立った段階における追加資金調達に関する事実上の確約をあらかじめ取得しておくことが望ましいと考え、Qualcommとの二段階に分けた第三者割当増資を前提にした共同開発・出資契約を平成24年12月4日に締結したものです。

第1次第三者割当増資の概要

(1) 募集株式の種類及び数	普通株式 30,120,000株（平成25年3月21日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,140,819,887株から第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を除いた1,110,699,887株に対して2.71%）
(2) 発行価格	164円
(3) 発行価額の総額	4,939,680,000円
(4) 資本組入額	82円
(5) 資本組入額の総額	2,469,840,000円
(6) 募集方法	第三者割当の方法による。
(7) 申込期間	平成24年12月26日
(8) 払込期間	平成24年12月27日
(9) 割当先及び割当株数	Qualcomm Incorporated 30,120,000株

第1次第三者割当増資に関しては、平成24年12月27日の払込期日に払込みが完了しております。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との関係は、平成24年12月30日現在におけるものであります。

a. 割当予定先の概要	名称	Qualcomm Incorporated	
	本店の所在地	アメリカ合衆国 カリフォルニア州92121 サンディエゴ モアハウス・ドライブ5775 (5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, U.S.A.)	
	国内の主たる事務所の責任者及び連絡先	クアルコムジャパン株式会社 代表取締役社長 Clifford Ficke 03-5412-8900(代表)	
	代表者の役職及び氏名	Chairman of the Board and Chief Executive Officer Paul E. Jacobs	
	資本金	171,600USドル (なお、資本準備金は12,282百万USドル)	
	事業内容	CDMA（符号分割多重接続）技術を使う各種の移動通信システムや端末向けのベースバンド・チップセットの開発・販売、及びCDMAに係るライセンスの供与等	
	主たる出資者及び出資比率	BlackRock Advisors, LLC 6.12%	
b. 提出者と割当予定先との関係	出資関係	当社が保有している割当予定先の株式の数	該当事項はありません。
		割当予定先が保有している当社の株式の数	30,120,000株
	人事関係	該当事項はありません。	
	資金関係	該当事項はありません。	
	技術又は取引関係	当社は、割当予定先との間で、携帯電話(スマートフォン)用チップセットの購買等に関する取引関係があります。	

c. 割当予定先の選定理由

当社を取り巻く事業環境は円高に加え、主要事業である液晶事業における価格競争の激化などにより、厳しさを増しております。このような厳しい環境の下、事業構造改革の一環として、当社の最先端技術であるIGZO-TFT技術など競争優位性を有する中小型液晶事業を今後の当社の成長エンジンと位置づけ、伸長が見込まれるモバイル機器用ディスプレイ市場などに向け、IGZO液晶搭載商品の拡大、顧客の拡大を実現することにより、収益の拡大に取り組んでおります。しかしながら、モバイル機器向けのディスプレイにおいても技術開発競争と価格競争が熾烈化しており、当社の市場における地位を維持・向上するためには、新たな技術開発を継続する必要があります。

中小型液晶事業のターゲットであるスマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器の市場は、その拡大が進むにつれ、搭載するディスプレイにも更なる視認性の高さや低消費電力化が求められることが見込まれています。そこで、このたび、当社は、前記「第1〔募集要項〕 2〔株式募集の方法及び条件〕（2）〔募集の条件〕」に記載のとおり、当社が保有するIGZO-TFT技術とPixtronixが保有するMEMSディスプレイ技術を持ち寄り、更なる画質の向上と低消費電力を実現するモバイル機器向け次世代MEMSディスプレイの共同開発を目的とする共同開発・出資契約を締結することで合意いたしました。

当社は、これによりMEMSディスプレイが優位性を持つと考える色再現性に加え、IGZO-TFT技術の特長である高速速度と低消費電力を生かすことによって、世界初になると考えられるMEMSディスプレイの開発と実用化を効率的に実現することが可能となり、技術開発競争と価格競争が厳しい経営環境においても、品質の向上を確保することで安定的な収益確保については当社の企業価値の向上に結び付けられる、と考えております。

このように、PixtronixのMEMSディスプレイ技術はかかるモバイル機器向け次世代MEMSディスプレイの共同開発のため不可欠な技術と考えており、同社と共同開発契約を締結し、パートナーとすることは両社にとって大きなメリットをもたらすものとの結論に達しました。また、これに伴い、Pixtronixとの共同開発契約による提携を確実に推進するために、同社の親会社であるQualcommを割当予定先とした本第三者割当増資及び第1次第三者割当増資に関する共同開発・出資契約を締結することを決定したものです。

平成24年11月1日公表の平成25年3月期第2四半期決算及び平成25年2月1日公表の平成25年3月期第3四半期決算において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、幅広い対策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと考えます。しかしながら、平成24年12月末現在の自己資本比率は、9.6%まで低下するに至っており、本第三者割当増資は、財務体質改善に向け、当社の資本政策上も有意義なものであると判断しております。また、今後の資本政策については、当社の財務状況に鑑みて、今後の資本の充実に向けたしかるべき検討を行い、企業価値の向上に努めてまいります。

また、当社は、新たな事業構造改革の一環として、特に液晶事業の収益力改善・安定化に向けた改革を継続的に推進しており、その具体的な施策として、本第三者割当増資及び第1次第三者割当増資に加えて、平成24年3月27日決議第三者割当増資及び平成25年3月6日決議第三者割当増資に取り組んでおります。

d . 割り当てようとする株式の数

Qualcomm Incorporated 18,561,000株

ただし、上記は、前記「第1〔募集要項〕1〔新規発行株式〕」に記載の発行数の暫定数値です。

e . 株式等の保有方針

本割当予定先であるQualcommとは出資契約を締結しており、同契約において下記のとりの譲渡制限に同意しており、第1次第三者割当増資及び本第三者割当増資により割り当てる当社普通株式の保有方針について、当社の安定株主及び次世代MEMSディスプレイの共同研究に係る事業パートナーとして継続的に保有する方針であることを確認しています。

また、共同開発・出資契約において、本割当予定先であるQualcommは、本第三者割当増資が実施されてから1年間は、当社の事前の書面による承諾がある場合及び当社による共同開発・出資契約等に関する重大な契約違反がある場合を除き、本第三者割当増資により割り当てる当社普通株式の全部又は一部を第三者に譲渡しないことに合意しております。

また、本割当予定先であるQualcommは、共同開発・出資契約において、本第三者割当増資の払込日から1年経過した日以降2年目までの間に、その保有する当社の株式を、取引市場で売却する場合には一定の売却数量制限に服するものとし、また、取引市場外で第三者に譲渡しようとする場合には、当社に対して30日前に通知を行い、当社と売却先及び売却条件について協議し、当社が所定の条件を充たす売却先を指定した場合には当該売却先に売却することについて合意しております。

なお、当社は、本割当予定先であるQualcommより、本第三者割当増資の割当日から2年以内に当社普通株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に報告すること、並びに当社が当該報告内容を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に報告すること及び当該報告内容が公衆縦覧に供されることに同意することにつき、それぞれ確約書を取得する予定です。なお、第1次第三者割当増資に係る確約書はすでに取得済みです。

f . 払込みに要する資金等の状況

当社としては、本割当予定先であるQualcommから開示されたQualcommの直近(2013年9月期第1四半期)を含む財務諸表を確認しております。これらによれば、Qualcommの2012年12月30日付の連結財務諸表においては、総資産44,841百万USドル、純資産35,354百万USドル並びに現金・預金及び現金同等物4,293百万USドルとなっております。これらによりQualcommが十分な資金力を有していることが確認できることから、本第三者割当増資の払込みについて問題はないと判断しております。

g . 割当予定先の実態

本割当予定先であるQualcommは、米国NASDAQ証券取引所に上場しております。米国では、反社会的行為を規制するThe Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Actが存在し、Qualcommは米国NASDAQ証券取引所上場企業として同規則によりこうした法令の遵守の徹底を求められていること、また、当社は、割当予定先であるQualcommから、同社の知る限り、同社の役員及び主要株主が暴力団等とは一切関係がない旨の表明を取得しております。これらのことにより、当社は、本割当予定先が暴力団等とは一切関係がないと判断しており、その旨の確認書を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所に提出しております。

2【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

3【発行条件に関する事項】

(1) 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方

払込金額につきましては、本取締役会において、追加投資主要条件充足日の2営業日前の日から遡った20営業日の間の株式会社東京証券取引所における当社の終値の単純平均値(1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げます。)とすることに決定いたしました。この算定方法は、旧第2次第三者割当増資と同じです。

追加投資主要条件充足日の2営業日前の日から遡った20営業日の間の終値の単純平均値を参考としたのは、本第三者割当増資に係る払込期日が一定期間先の将来の日となっていることを考慮すると、適正な払込金額水準に関しては前もって決定することが適切ではない面もあり、本第三者割当増資の払込金額についてその発行直前の比較的短期間の株価水準を参考にしたほうがよいと考えたためです。また、当社の株価は、ここ1年ほどの間、昨今の業績不振や通期計画の下方修正を受けてそれ以前の市場価格と比べて大幅に下落した水準となる等、現状の株価は変動が大きいことに鑑みると、特定の日ににおける価格のみを参考にするよりも、価格決定時の直近の比較的短期間の平均値を参考とすることの方が妥当と判断したものです。

本第三者割当増資の払込金額が有利発行に当たらないかどうかの判断に関しては、本有価証券届出書提出日時点では、その判断の前提となる払込金額が確定していないことから、払込金額が確定した時点で判断する予定です。

(2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

第1次第三者割当増資により、本割当予定先に対して割り当てた当社普通株式の数量30,120,000株は、平成25年3月21日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,140,819,887株から第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を除いた1,110,699,887株に対して2.71%(議決権総数1,095,302個(注)に対する割合2.75%)となり、さらにこれに追加して、本第三者割当増資により本割当予定先に対して当社普通株式が割り当てられる予定です。

しかしながら、前記「第1【募集要項】4【新規発行による手取金の使途】(2)【手取金の使途】」及び「第3【第三者割当の場合の特記事項】1【割当予定先の状況】c.割当予定先の選定理由」に記載のとおり、第1次第三者割当増資により調達する資金は、当社の優位性及び成長性を確保する上で重要となるモバイル機器向けの次世代MEMSディスプレイの共同開発に係わる投資等に充当することで、当社グループの中長期的な収益力向上及び競争力強化に資するものであり、ひいては中長期的な当社グループの企業価値及び株主利益の向上に寄与するものであることから、第1次第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。なお、平成24年3月27日決議第三者割当増資により鴻海精密工業股? 有限公司等に割り当てる予定の当社普通株式の数量121,649,000株、第1次第三者割当増資によりQualcommに割り当てた当社普通株式の数量30,120,000株及び平成25年3月6日決議第三者割当増資によりサムスン電子ジャパンに対して割り当てる予定の当社普通株式の数量35,804,000株の総数187,573,000株は、平成25年3月21日現在の当社普通株式の発行済株式総数1,140,819,887株から第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を除いた1,110,699,887株に対して16.89%(議決権総数1,095,302個(注)に対する割合17.13%)となっております。

(注) 議決権総数は発行済株式総数1,140,819,887株から、平成24年9月30日時点の株主名簿に基づく単元未満株式4,939,887株、自己保有株式(単元未満株式を除く)10,383,000株及び相互保有株式75,000株並びに第1次第三者割当増資により発行した当社普通株式の数量30,120,000株を控除して算出したものです。

本第三者割当増資による発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であるかどうかに関しては、本有価証券届出書提出日時点では、その判断の前提となる発行価格が確定していないことから、発行価格が確定した時点で判断する予定です。

4【大規模な第三者割当に関する事項】

本第三者割当増資について大規模な第三者割当増資に該当するかどうかは、本第三者割当増資に係る本有価証券届出書提出時点において発行数が確定していないため未定です。

5【第三者割当後の大株主の状況】

本第三者割当増資に関しては、本有価証券届出書提出時点では、発行新株式数が確定していないことから未定です。

6【大規模な第三者割当の必要性】

本第三者割当増資について大規模な第三者割当増資に該当するかどうかは、本第三者割当増資に係る本有価証券届出書提出時点において発行数が確定していないため未定です。

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。

第二部【公開買付けに関する情報】

第1【公開買付けの概要】

該当事項はありません。

第2【統合財務情報】

該当事項はありません。

第3【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】

該当事項はありません。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第118期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）平成24年6月26日関東財務局長に提出

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第119期第1四半期（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月7日関東財務局長に提出

3【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第119期第2四半期（自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日）平成24年11月7日関東財務局長に提出

4【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第119期第3四半期（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月8日関東財務局長に提出

5【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づく臨時報告書を平成24年6月28日に関東財務局長に提出

6【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号に基づく臨時報告書を平成24年7月9日に関東財務局長に提出

7【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく臨時報告書を平成24年8月13日に関東財務局長に提出

8【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく臨時報告書を平成24年11月1日に関東財務局長に提出

9【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく臨時報告書を平成24年11月5日に関東財務局長に提出

10【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく臨時報告書を平成24年11月20日に関東財務局長に提出

第2【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日（平成25年3月22日）現在において変更の必要はないと判断しております。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

シャープ株式会社本社
（大阪市阿倍野区長池町22番22号）
シャープ株式会社東京支社
（東京都港区芝浦一丁目2番3号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
株式会社大阪証券取引所
（大阪市中央区北浜一丁目8番16号）

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。